



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金

端子基材: 黄铜

产品端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子基材	黄铜

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	60000
------	-------

封装方法

Reel, 零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

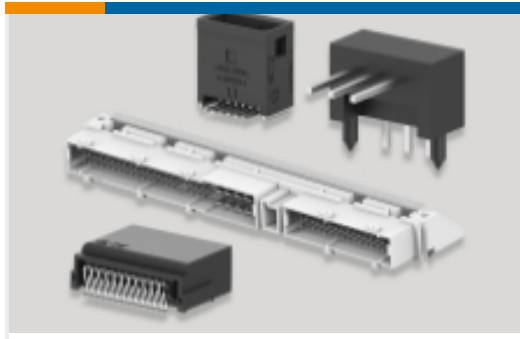
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

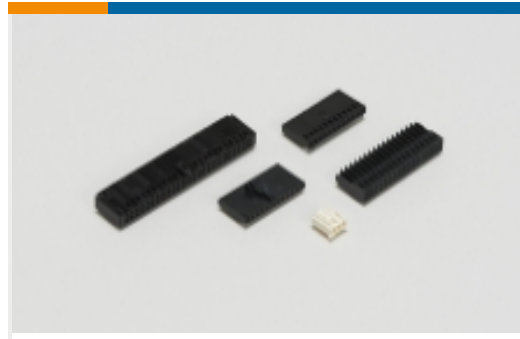
配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPMODU Headers](#)



PCB 板端连接器及母端(4353)



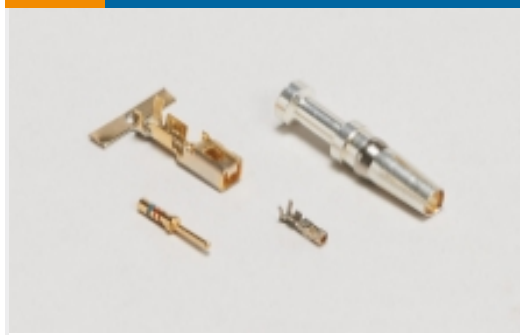
线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(2)

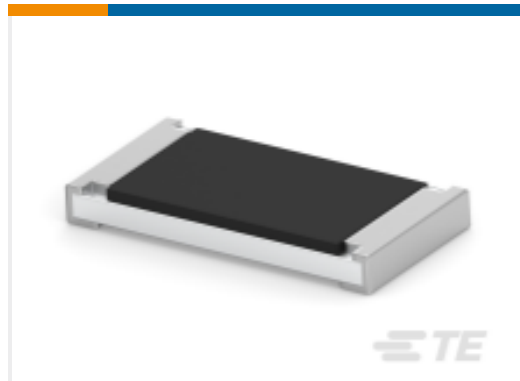


连接器端子(64)

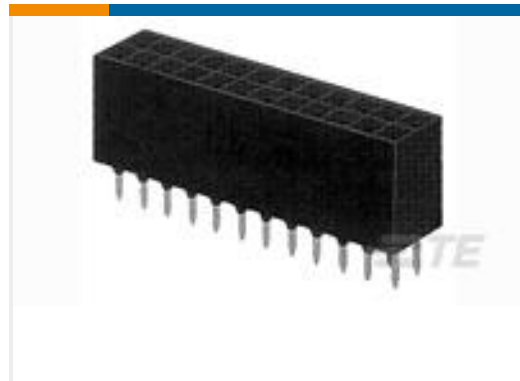
客户还购买了



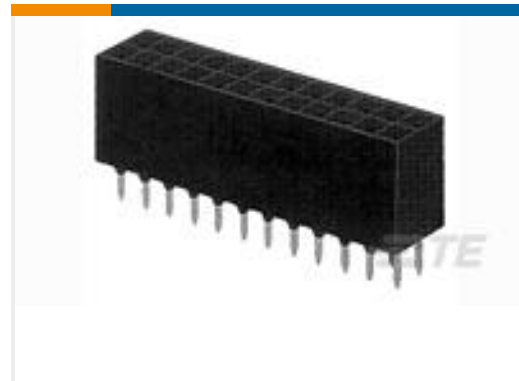
TE 产品编号02561037-000
LVDT M12 20 ASSY



TE 产品编号1-1879463-8
厚膜电阻器：电流感应



TE 产品编号1-534236-2
24 MODII VRT DR CE 100/120



TE 产品编号6-534236-2
24 MODII VRT DR CE 100/120



TE 产品编号755405-1
SAHT LOW PROFILE MINI AMP 30-22
ASSY



TE 产品编号1617149-5
JMGSC-26M = M39016/41-036M



TE 产品编号YDTS24T09-35PNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

[.025 SQ POST W/STAR 15U .424](#)

英文版本

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)